公司代码:688432　　公司简称:有研硅

# 有研半导体硅材股份公司

## 【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 有研硅 | 688432 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杨凌 | 孙媛 |
| 电话 | 010-82087088 | 010-82087088 |
| 办公地址 | 北京市西城区新街口外大街2号D座17层 | 北京市西城区新街口外大街2号D座17层 |
| 电子信箱 | griteksipo@griteik.com | griteksipo@griteik.com |

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,291,220,929.36 | 5,367,768,357.56 | -1.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,387,235,114.27 | 4,341,587,040.23 | 1.05 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 490,914,928.21 | 507,160,800.32 | -3.20 |
| 利润总额 | 150,265,363.22 | 168,278,491.44 | -10.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 106,034,746.36 | 130,483,111.10 | -18.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,565,381.21 | 91,347,717.44 | -19.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,644,084.71 | 74,396,899.83 | 97.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.42 | 3.11 | 减少0.69个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.10 | -18.64 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.10 | -18.65 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 9.01 | 8.49 | 增加0.52个百分点 |

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末股东总数(户) | 20,488 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | / |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京有研芯测半导体科技有限公司 | 境内非国有法人 | 30.84 | 384,750,000 | 384,750,000 | 384,750,000 | 无 | 0 |
| 株式会社RS Technologies | 境外法人 | 26.22 | 327,090,400 | 327,090,400 | 327,090,400 | 无 | 0 |
| 中国有研科技集团有限公司 | 国有法人 | 18.47 | 230,422,500 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 福建仓元投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.26 | 28,215,000 | 28,215,000 | 28,215,000 | 无 | 0 |
| 德州芯利咨询管理中心（有限合伙） | 其他 | 1.15 | 14,319,986 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 国新风险投资管理（深圳）有限公司－深圳诺河投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.06 | 13,278,689 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.71 | 8,881,083 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.71 | 8,854,346 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 德州芯睿咨询管理中心（有限合伙） | 其他 | 0.69 | 8,559,953 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.44 | 5,492,549 | 0 | 0 | 无 | 0 |

上述股东关联关系或一致行动的说明　1.北京有研芯测半导体科技有限公司、株式会社RS Technologies实际控制人为方永义。2.RS Technologies与仓元投资已签署一致行动协议。3.中信证券之全资子公司中证投资持有公司0.44%的股份,持有研投基金2.74%的出资份额。4.除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688432　证券简称:有研硅　公告编号:2025-027

# 有研半导体硅材料股份公司关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)董事会近日收到孙根志华先生提交的书面辞职报告,因个人原因,孙根志华先生申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员职务,孙根志华先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司于2025年8月12日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,经提名委员会审核,董事会同意提名黄莺女士为公司第二届董事会独立董事候选人,该议案尚需提交公司股东会议。

一、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙根志华 | 独立董事、董事会提名委员会委员 | 自公司股东会选举产生新的独立董事之日 | 2027年5月26日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否 |

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》(《公司章程》)及相关规定,孙根志华先生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一,不会导致独立董事中设有会计专业人士,且孙根志华先生未担任董事会下属各委员会的召集人,不会影响董事会依法规范运作,也不会影响公司正常的经营发展。但其辞职会导致公司董事会提名委员会的独立董事未过半数,因此孙根志华先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。为了确保董事会的正常运作,在公司股东会选举产生新任独立董事之前,孙根志华先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

截至本公告披露之日,孙根志华先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对孙根志华先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

二、补选独立董事候选人的情况

公司于2025年8月12日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,根据控股股东株式会社RS Technologies推荐,经提名委员会审核,董事会同意提名黄莺女士(简历附后)为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

黄莺女士已参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训并取得相应培训记录证明。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,尚需提交公司股东会审议。

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,若黄莺女士当选公司独立董事,将同时担任董事会提名委员会委员,任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2025年8月14日

附:独立董事候选人简历

黄莺女士,1963年出生,中国国籍,具有日本境外永久居留权,博士研究生学历。2004年6月至2018年1月任职安永新日本有限责任会计师事务所担任中国业务负责人;2018年2月至2025年6月任职普华永道日本合同会社担任中国业务负责人;2024年4月至今任职日本中央大学担任讲师;2025年7月至今任职Osmanthus United LLC担任首席执行官。

截至本公告披露日,黄莺女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:688432　证券简称:有研硅　公告编号:2025-028

# 有研半导体硅材料股份公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)董事会将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2047号),同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)18,714.3158万股,每股发行价格为9.91元,募集资金总额为人民币185,458.87万元,扣除不含税发行费用,实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年11月7日出具《验资报告》(毕马威华振验字第2201588号)。

(二)募集资金使用情况

根据公司募投项目规划,首次公开发行超募资金总额为6.63亿元。截至2025年6月30日,已使用3.85亿元用于永久补充流动资金,0.36亿元(含印花税、交易佣金等交易费用)用于股份回购,尚未使用的超募资金余额为2.43亿元。

2022年3月28日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金19,500.00万元用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2023年3月30日披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

2024年3月27日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金19,000.00万元用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2024年3月29日披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司于2024年2月20日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,回购的股份将用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划。具体详见公司于2024年2月21日、2024年2月28日和2024年5月6日披露的《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》、《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》和《有研硅关于回购完成暨回购实施结果的公告》。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

公司已与保荐人中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司、本公司之子公司山东有研半导体材料有限公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司北京春路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议对本公司(及子公司)、保荐人及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至2025年06月30日,公司均严格按照该募集资金专户存储三方/四方监管协议的规定,存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年06月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/万元

| 开户银行名称 | 银行账号 | 金额 |
|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司北京东单支行 | 637336316 | 3,757.58 |
| 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 110907342310257 | 184.22 |
| 中信银行北京中信大厦支行 | 8110701013402425110 | 3,227.52 |
| 中国工商银行股份有限公司北京航天城支行 | 0200030269190000122852 | 93.36 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行 | 91170078801400000272732 | 6,314.07 |

注:上述专户存储金额不包含用于现金理财的募集资金5.00亿元。

三、本次使用超募资金新建投募项目的具体情况

(一)项目基本情况

1.项目名称:8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化

2.建设地点:北京市顺义区双河大街10号

3.建设单位:有研半导体硅材料股份公司

4.项目建设期周期:2025年7月至2026年12月

5.投资金额及资金来源:计划投资金额人民币4,833万元,资金来源为公司部分超募资金。

6.建设内容:

(1)项目资金将用于8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化;

(2)项目改造主要涉及区熔炉二次配等工作,不涉及厂房基础结构的变化;

(3)项目固定资产投资主要为区熔单晶炉、晶体加工设备,用于8英寸区熔单晶的产能和技术提升,建成后可新增8英寸区熔单晶产能21吨/年。

投资类型具体如下:

| 投资类型 | 设备 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 固定资产 | 区熔单晶炉 | 4,500 |
| | 晶体加工设备 | 130 |
| | 设备二次配工程 | 100 |
| 流动资金 | | 103 |
| 合计 | | 4,833 |

注:设备二次配工程是指在洁净室投入运转后,在对原有洁净室区域的洁净度、空气分子污染程度、微振动、温度、湿度、气压、静电等指标影响最小的情况下,为新接入设备和生产线做二次洁净室配套(如电力系统、水处理系统、气流风路系统等)工程。

本项目的实施将进一步提升公司区熔硅单晶技术的水平,有利于发展8英寸区熔硅单晶、拓展区熔高端市场,提高区熔硅单晶市场占有率,对公司经营业绩将产生积极的影响。本项目的实施,有利于提升我国半导体硅材料行业的整体水平,推动国内相关新型电力电子器件、节能型功率器件等产业的发展,实现高端硅材料的规模化生产,增强我国功率器件用硅基材料国际竞争力,进一步拓展国际市场,对提升我国区熔硅单晶材料水平起到积极的推动作用。

(二)项目相关行业背景及必要性

区熔单晶硅是电子信息产业中的基础性材料,其相比于半导体产业常用的直拉单晶硅,具有高纯、低氧、高阻等特性,有利于器件和电路实现耐高压、高频、高寿命和电转换率,主要用于IGBT和节能灯用稳压管及可控硅等电力电子器件、射频及微波器件、传感器、MEMS器件、太阳能电池、探测器、LED等。其中IGBT作为新一代的功率半导体器件,性能优异,是功率半导体中的关键产品门类,可适用于各类需要进行交直流转换、电流电压转换的应用场景,在电网输变电、新能源汽车、轨道交通、新能源、变频家电等领域发挥重要的作用。

目前,新能源汽车功率半导体需求持续攀升,将推动区熔硅片行业进入供需紧张状态。我国在区熔硅单晶领域起步较晚,大部分功率切割领域国外企业占据,国内仅有少数企业具备研发和产业化能力,特别是在代表先进技术水平的大尺寸区熔硅单晶领域,主要依赖进口,实现大尺寸区熔硅单晶的自主保障势在必行。公司将紧抓市场机遇,进一步提高8英寸区熔硅片的产能,不断扩大市场份额,实现营收稳步增长。

(三)项目实施的可行性

公司拥有经验丰富的研发团队,并在项目研发方向上的相关领域具备一定的技术积累。本项目的研发方向和研究内容符合半导体行业的发展趋势,与公司现有主营业务产品的技术关联度较高,现有技术积累为项目实施提供技术支撑。

从市场来看,目前国内主要技术成果仍然应用于区熔单晶产品的开发运营,产业化成果所面向的客户群体、目标市场与公司现有产品一致,可以共享公司现有的市场、客户等渠道资源。

(四)项目实施的风险分析

公司基于当前经济形势、市场需求、技术发展趋势等综合因素考虑,使用部分超募资金新建募集资金投资项目,存在实现研发风险、市场竞争风险、项目建设风险、技术迭代风险等不确定因素,如果新建募集资金投资项目未能如期实现目标,或建成后市场情况发生不可预见的变化,可能存在市场拓展无法在预定时间内达到预期效果、市场开发投入超出预算的风险。

四、募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况

为了提高募集资金的使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为本公司及股东获取更多回报,2024年10月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及本公司正常业务开展的情况下,使用不超过人民币80,000万元(含超募资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-050)

截至2025年06月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币/万元

| 银行名称 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 | 起止日期 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国民生银行北京分行 | 结构性存款 | 浮动收益 | 27,000.00 | 2025.06.20-2025.09.18 | 否 |
| 中信银行北京分行 | 结构性存款 | 浮动收益 | 18,000.00 | 2025.04.01-2025.07.02 | 否 |
| 渤发银行北京分行 | 结构性存款 | 浮动收益 | 5,000.00 | 2025.06.26-2025.09.25 | 否 |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司2025年半年度募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2025年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《募集资金管理制度》使用募集资金,并真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资的情况。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2025年8月14日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

| 募集资金总额(注1) | | | | 1,663,967,265.37 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 81,408,618.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 1,081,972,238.13 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1)(注3) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充研发与运营资金 | 无 | 257,828,100.00 | 257,828,100.00 | 257,828,100.00 | 38,314,991.28 | 219,296,022.47 | -38,533,077.53 | 85.05 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 集成电路用抛光硅片扩产项目 | 无 | 384,824,300.00 | 384,824,300.00 | 384,824,300.00 | 30,126,962.04 | 283,678,643.96 | -101,145,656.04 | 73.72 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 集成电路刻蚀设备用硅材料项目 | 无 | 357,347,600.00 | 357,347,600.00 | 357,347,600.00 | 12,966,665.18 | 158,062,894.11 | -199,284,705.89 | 44.23 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | —— | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 81,408,618.50 | 661,038,560.54 | -338,961,439.46 | 66.10 | —— | —— | —— | —— |
| 超募资金永久补流(注2) | 无 | 不适用 | 385,000,000.00 | 385,000,000.00 | - | 385,000,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 股份回购(注2) | 无 | 不适用 | 35,935,687.59 | 35,935,687.59 | - | 35,935,687.59 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | —— | 1,000,000,000.00 | 1,420,935,687.59 | 1,420,935,687.59 | 81,408,618.50 | 1,081,972,238.13 | -338,961,439.46 | 76.15 | —— | —— | —— | —— |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | 详见附注4 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 报告期内,公司未发生此情况 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 报告期内,公司未发生此情况 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | 详见三、(四)闲置募集资金进行现金管理情况 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 报告期内,公司未发生此情况 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 报告期内,公司未发生此情况 | | | | | | | | |

注1:“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币1,663,967,265.37元。

注2:截至2025年06月30日,超募资金总额663,967,265.37元,其中385,000,000.00元用于永久补流,35,935,687.59元(含印花税、交易佣金等交易费用)用于股份回购。

注3:由于公司未承诺截至期末投入金额,此处填写为募集资金承诺投资总额。

注4:未达到计划进度原因主要基于以下因素:第一,受市场需求变动的影响,公司根据行业技术的最新发展情况进行了工艺优化,使得募投项目的实际投资进度与原预期计划存在差异。第二,本着控制成本、提高募集资金使用效率的原则,公司逐步调整了投资节奏。“集成电路用抛光硅片扩产项目”分两个阶段执行,第一阶段5万片/月扩产已于2024年建设完成并达产。截至本公告披露日,已完成金额10万片/月新增产能,预计2025年年底实现项目验收。“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”受厂房设计及招投标等客观因素影响,开工较预期延迟。

证券代码:688432　证券简称:有研硅　公告编号:2025-029

# 有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●投资项目:8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化(以下简称“本投资项目”)

●投资金额及资金来源:计划投资金额人民币4,833万元,资金来源为有研半导体硅材料股份公司(以下简称“有研硅”、“公司”)部分超募资金。

●项目建设期计划为2025年7月至2026年12月,最终以实际建设情况为准。

●本投资项目已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过,保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对本事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议。

●本次募集资金投资项目不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

●相关风险提示:

公司基于当前经济形势、市场需求、技术发展趋势等综合因素考虑,使用部分超募资金新建募集资金投资项目,存在如研发风险、市场竞争风险、项目建设风险、技术迭代风险等不确定因素,如果新建募集资金投资项目未能如期实现目标,或建成后市场情况发生不可预见的变化,可能存在市场拓展无法在预定时间内达到预期效果、市场开发投入超出预算的风险。

一、募集资金及募投项目基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

根据《中国证券监督管理委员会《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2047号),同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)18,714.3158万股,每股发行价格为9.91元,募集资金总额为人民币185,458.87万元,扣除不含税发行费用,实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年11月7日出具《验资报告》(毕马威华振验字第2201588号)。

(二)募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计使用募集资金100,056.36万元,本年度实际使用募集资金8,140.86万元。截至2025年06月30日,募集资金余额为63,576.75万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),募集资金专项账户余额为13,576.75万元,与募集资金余额相差50,000.00万元均为未到期的现金管理余额。

募集资金具体使用情况如下:

单位:人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金专项账户期初余额 | 158,569,195.04 |
| 减:本年度投入募集资金总额 | 81,408,618.50 |
| 减:项目相关信用证及银承保证金存入和除实际对外支付净额 | -2,917,350.81 |
| 减:对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品投入减去赎回本金净额 | -50,000,000.00 |
| 减:支付的其他发行费用 | - |
| 加:报告期内对募集资金进行现金管理取得的收益及利息收入扣除手续费净额 | 5,689,600.20 |
| 募集资金专项账户期末余额 | 135,767,536.55 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司、本公司之子公司山东有研半导体材料有限公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司北京春路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议对本公司(及子公司)、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至2025年06月30日,公司均严格按照该募集资金专户存储三方/四方监管协议的规定,存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年06月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/万元

| 开户银行名称 | 银行账号 | 金额 |
|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司北京东单支行 | 637336316 | 3,757.58 |
| 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 110907342310257 | 184.22 |
| 中信银行北京中信大厦支行 | 8110701013402425110 | 3,227.52 |
| 中国工商银行股份有限公司北京航天城支行 | 0200030269190000122852 | 93.36 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行 | 91170078801400000272732 | 6,314.07 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的使用情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金,公司本报告期募投项目的资金使用情况,详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为本公司及股东获取更多回报,2024年10月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及本公司正常业务开展的情况下,使用不超过人民币80,000万元(含超募资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-050)。

截至2025年06月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币/万元

| 银行名称 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 | 起止日期 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国民生银行北京分行 | 结构性存款 | 浮动收益 | 27,000.00 | 2025.06.20-2025.09.18 | 否 |
| 中信银行北京分行 | 结构性存款 | 浮动收益 | 18,000.00 | 2025.04.01-2025.07.02 | 否 |
| 渤发银行北京分行 | 结构性存款 | 浮动收益 | 5,000.00 | 2025.06.26-2025.09.25 | 否 |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司2025年半年度募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2025年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《募集资金管理制度》使用募集资金,并真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资的情况。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2025年8月14日

证券代码:688432　证券简称:有研硅　公告编号:2025-025

# 有研半导体硅材料股份公司关于取消监事会、修订《公司章程》、制定和修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)于2025年8月12日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司取消监事会、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》,现将相关情况公告如下:

一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使。《有研半导体硅材料股份公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《有研半导体硅材料股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相关条款及《有研半导体硅材料股份公司董事会审计委员会实施细则》等相关规则亦作出相应修订。

在公司股东会审议通过该事项之前,公司第二届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行职责,维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》的相关情况

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。<br>总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。<br>法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 |
| 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。<br>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。<br>法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任,公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。 |
| 